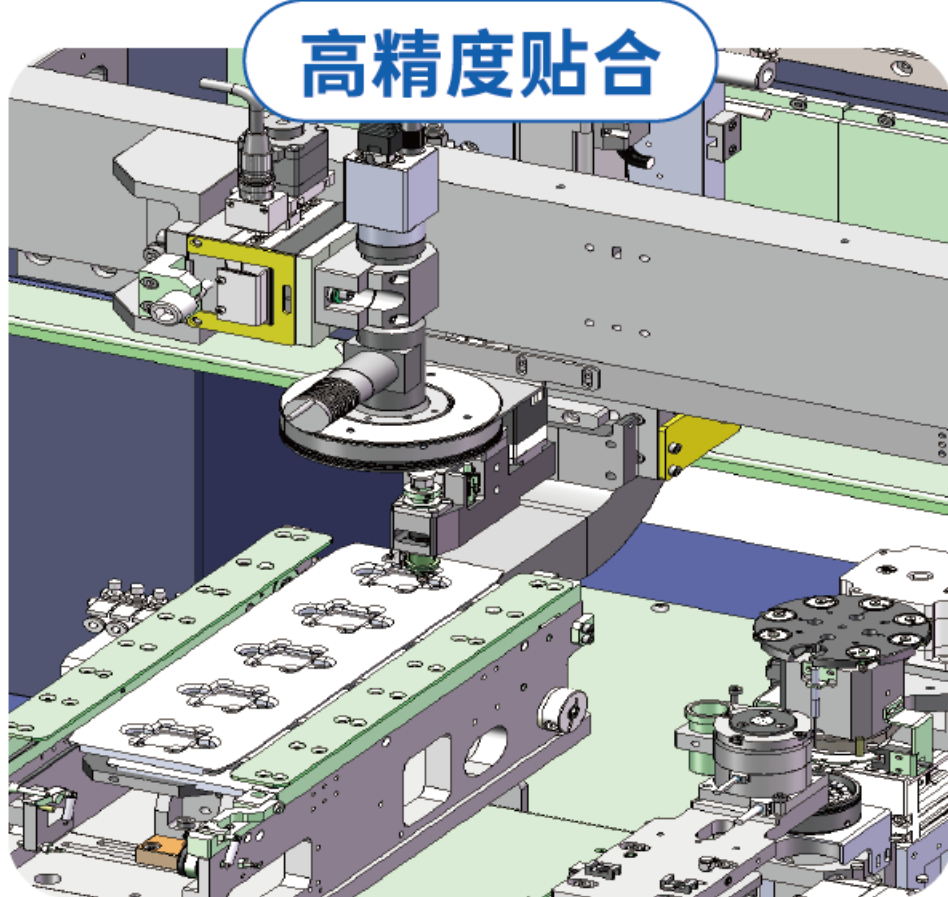
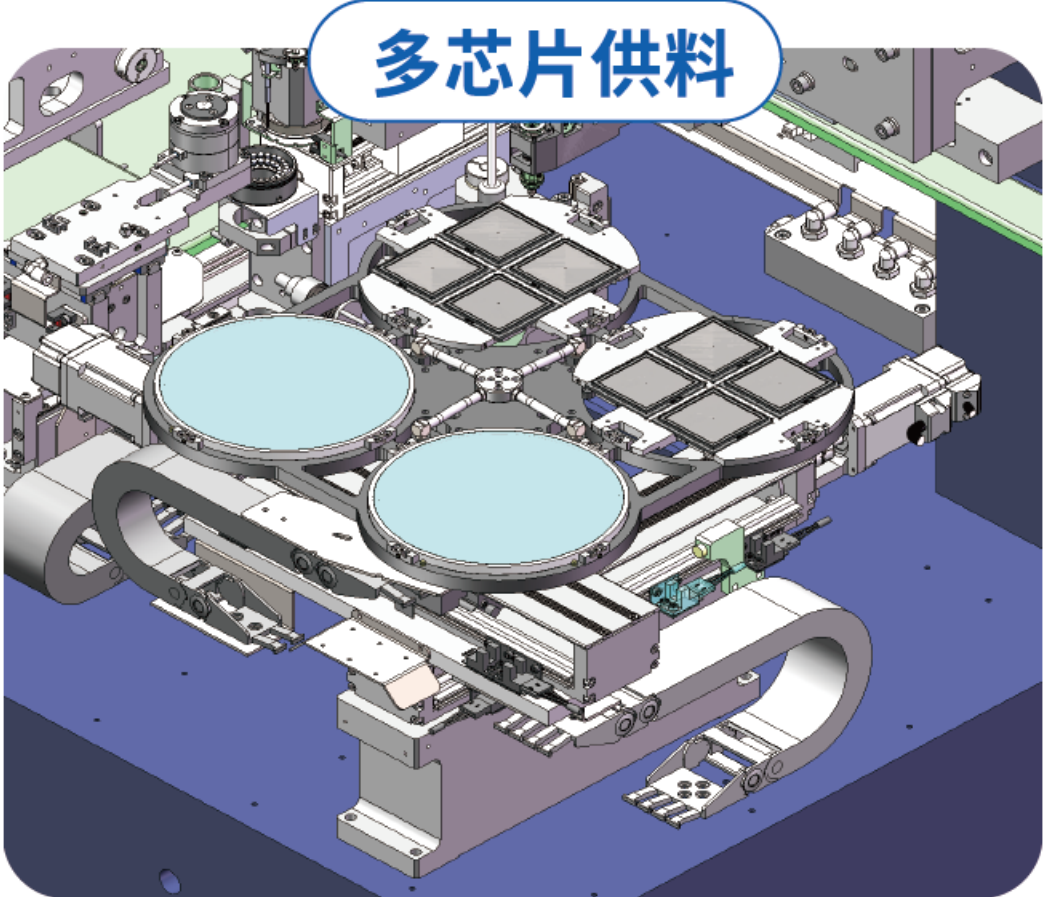
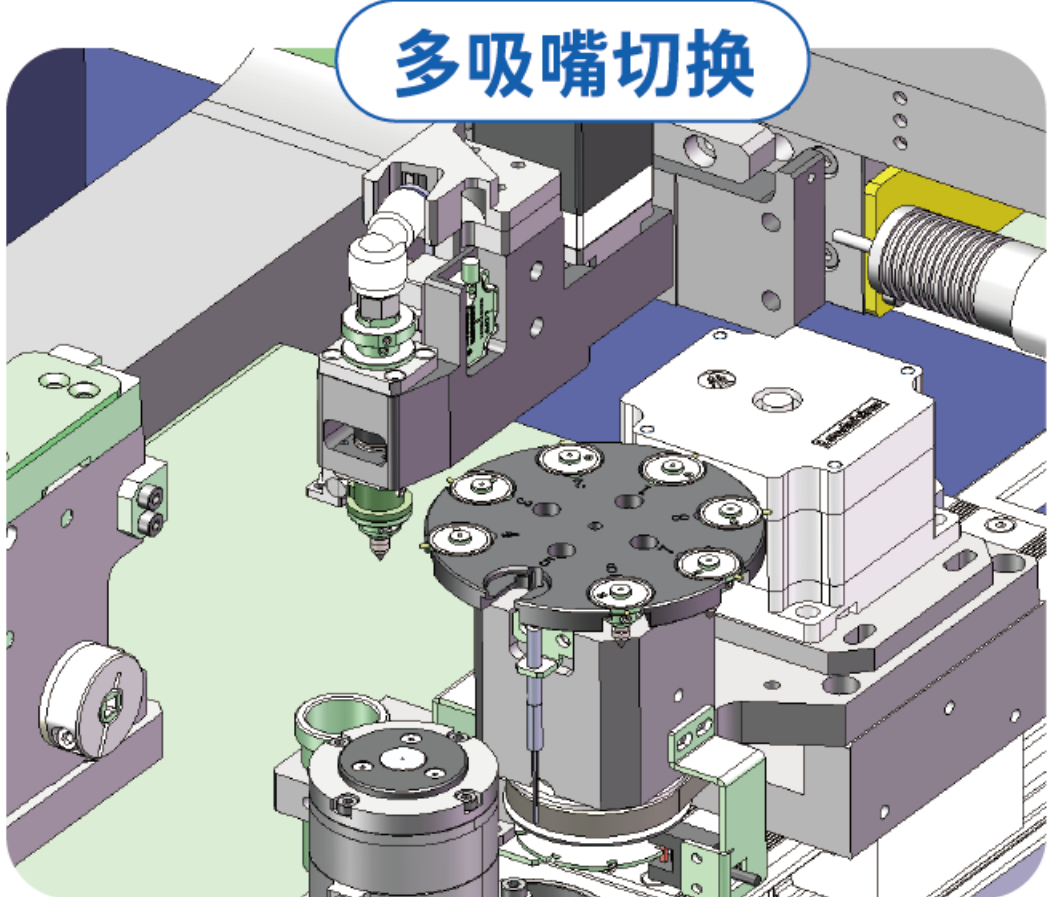




高精度自动固晶机

产品特性

- 高精度贴装±3um / ±5um
- 适用于COB、BOX等光器件和传感器的多芯片混合贴装
- 支持最多4种吸嘴自动更换
- 支持点胶和画胶系统共存
- 灵活的材料处理能力：最多支持4个6寸晶圆环；可选Waffle Pack、Gel-Pak，或定制夹具



性能参数

序号	项目	指标
01	贴片位置精度	±5um @3 sigma ±3um (标准片)
02	贴片角度精度	±0.3° @3 sigma
03	贴合压力	10gf~200gf (可编程)
04	单颗贴合时间	≤ 6秒
05	点胶系统	蘸胶或画胶
06	顶针系统	1套
07	上料系统	6寸扩晶环4个
08	视觉校准系统	3套下视+1套上视相机 可选RGB三色光源
09	贴片尺寸	最小：0.12mm*0.12mm； 最大：5mm*5mm
10	基板载具尺寸	宽度：50~100mm； 长度：50~200mm
11	上料下料料盒	2个
12	电源	200-240VAC, 50-60Hz, 3000W
13	气源	压缩空气： 0.5~0.6Mpa / 真空： -60~-80KPa
14	机器尺寸	1240mm(L)x1160mm(W)x1830mm(H)
15	机器重量	1200kg